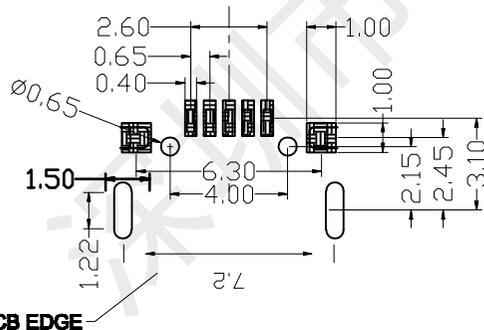
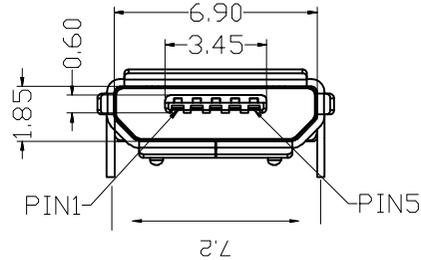
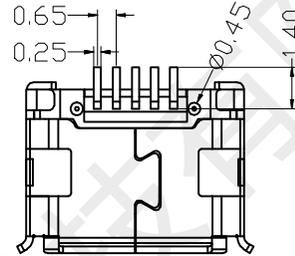
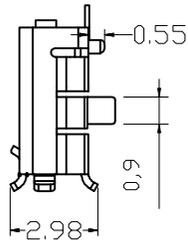
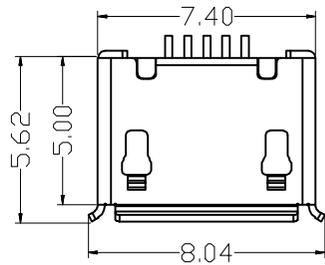
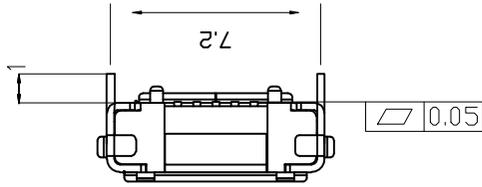


REV.	DESCRIPTION	DRAWN/DATE	APPROVED/DATE



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05

NOTES:

1. MATERIAL:
  - 1.1 HOUSING:THERMOPLASTIC FLAMMABILITY RATING UL94-0
  - 1.2 CONTACT:COPPERY ALLOY T=0.15MM
  - 1.3 SHELL: COPPERY ALLOY T=0.25MM
2. FINISH:
  - 2.1 CONTACT:
    - 3U"MIN,PLATED ON CONTACT AREA
    - G/F PLATING ON SOLDER TAIL AREA
    - 50~80U" NICKEL UNDERPLATING OVERALL
  - 2.2 SHELL:
    - 80~120U" MATTER TIN PLAING ALL
    - 50~80U" NICKEL UNDERPLATING OVERALL
3. SPECIFICATION:
  - 3.3 CURRENT RATING:0.5A(2.3.4CONTACT)/1.0A (1.5CONTACT)MAX.
  - 3.2 VOLTAGE:30 VAC
  - 3.3 TEMPERATURE RANGE:-30°C~80°C
  - 3.4 CONTACT RESISTANCE:30 MILLIONHM MAX.
  - 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE;250VAC R.M.S
  - 3.6 INSULATION RESISTNACE:100 MEGOHMS MIN

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN DATE	深圳市首韩科技有限公司	
X. ±0.35	X' ±2.0'	李春风	FILE NAME<??>	
.X ±0.25	.X' ±1.0'	CHECK DATE	PART NO<??>	MICRO 7.2JB
.XX ±0.15	.XX' ±0.5'	钟华华	DRAWING NO<??>	
.XXX ±0.10		APPRO. DATE		
UNIT:mm	SCALE 1:1	罗孝金		
A4	SHEET: 1 of 1			REV. A0



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码  
material code:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

USB

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

MICRO 7.2JB

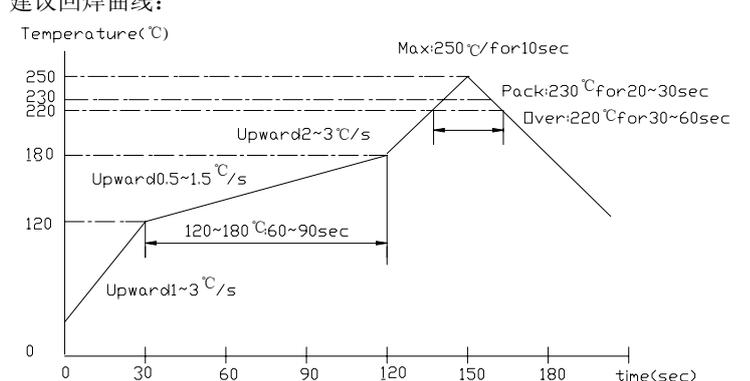
\_\_\_\_\_

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1 $\mu$ "			
1.3. 外壳部分: C2680R-H, 外壳镀镍底 50 $\mu$ " , 镀NI 80 $\mu$			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1.0Ampere			
2.2. 使用温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	30m $\Omega$ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100M $\Omega$ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	250V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.57kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	1.02kgf	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 <sup>-6</sup> 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C锡炉中浸泡 5 $\pm$ 0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于 85 $^{\circ}$ C的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于-40 $^{\circ}$ C的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m $\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 100M $\Omega$ MIN	将产品置于温度为 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50m $\Omega$ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C (120~180°C for 60~90sec), then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then rises at 2~3°C/s to 230°C (Pack: 230°C for 20~30sec, Over: 220°C for 30~60sec), peaks at 250°C (Max: 250°C for 10sec), and finally cools down.</p>